科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成24年 6月 5日現在

機関番号:13901
研究種目:基盤研究(A)
研究期間:2009~2011
課題番号:21246053
研究課題名(和文)
Ge-Si系量子ドットの自己整合複合集積による物性制御とエレクトロルミネッセンス
研究課題名(英文)
Control of Electronic Properties of One-Dimensionally Self-Aligned Si-Ge based
Quantum Dots and Its Electroluminescence
研究代表者
宮崎 誠一(MIYAZAKI SEIICHI)
名古屋大学・工学研究科・教授
研究者番号:70190759

研究成果の概要(和文):熱 SiO₂膜上のSi量子ドット上にGeを選択成長させ、酸化・高温熱処理を施した後、SiH₄-LPCVDを行うことによって、自己整合的に一次元連結した量子ドット構造を形成できた。さらに、連結ドットを超高密度形成(~10¹³cm⁻²)することで、半透明Auゲートダイオード構造において、高効率キャリア注入が実現でき、電流密度~0.15A/cm²においてEL強度をドット密度~10¹¹cm⁻²の場合と比べて~425倍増大することが分かった。また、p-Si(100)上に形成したダイオード構造では、その閾値電圧は、n型基板上に形成した場合に比べ、Auと基板の仕事関数差を反映して~0.8V増加し、EL積分強度の印加電圧および投入電力依存性を調べた結果、基板側ドット内に効果的に正孔保持が起こることに起因して、長波長側(~1140nm)で強い依存性を示すことが分かった。

研究成果の概要(英文): Self-aligned Si-based quantum dots (Si-QDs) have been successfully fabricated on ultrathin SiO₂ by controlling low-pressure chemical vapor deposition (LPCVD) using pure SiH₄ and/or Si₂H₆, selective Ge LPCVD from 5% GeH₄ diluted with He, thermal oxidation of the dots and subsequent thermal desorption of Ge oxide. In semitransparent Au-gate diodes with self-aligned dots so-prepared, when carriers were injected to the self-aligned Si-QDs from the n-Si(100) substrate for electrons and from the Au top electrode for holes, electroluminescence (EL) in the near-infrared region at room temperature becomes observable with an increase in current at positive biases over a threshold voltage as low as ~1.2 V at the Au top electrode. Note that, in the case of an areal dot density of ~10¹³ cm⁻², the EL threshold voltage was reduced down to ~60% of that of ~10¹¹ cm⁻² and emission intensity was enhanced markedly by a factor of ~425 in comparison with the case of ~10¹¹ cm⁻² under the same current density. This is clear evidence of not only an increase in radiative recombination rate in the self-aligned structure but also an improvement of recombination efficiency due to a decrease in current leakage with increasing dot density.

|--|

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2009 年度	16,500,000	4,950,000	$21,\!450,\!000$
2010 年度	11,600,000	3,480,000	15,080,000
2011 年度	7,300,000	2,190,000	9,490,000
総計	35,400,000	10,620,000	46,020,000

研究分野: 半導体工学 科研費の分科・細目: 電子・電気材料工学 キーワード: Si量子ドット,一次元連結,エレクトロルミネッセンス,LPCVD

1. 研究開始当初の背景

Ge-Si 系量子ドットを活性層に用いて、室

温・低電圧(1V 程度)で駆動できる極薄の高 効率・高速 EL デバイスが実現できれば、飛 躍的な進歩を遂げているシリコン ULSI 技術 をベースに Si 系量子ドットトランジスタや フローティングメモリデバイスを組み合わ せて、将来の少数電子・少数光子を使った大 規模な高度情報処理へと発展する可能性が 高い。

2. 研究の目的

IV 族半導体量子ドットを自己整合集積す ることができるプロセス技術を確立するこ とで、申請者らがこれまでに研究してきたコ ア/シェル構造を導入したゲルマニウム-シリ コン系量子ドットやイオン化不純物を添加 した Si 系量子ドットが一次元(縦積み)連結 したハイブリッド量子ドット系を新たに創 成し、結合ドット系固有の電子物性やこれに 付随する新規機能を実験的に明らかにする ことを第一の目標・目的とする。さらに、こ のハイブリッド量子ドット系におけるキャ リアダイナミックスを精査し、高効率キャリ ア注入とキャリア閉じ込を両立できるセル フアライン集積構造において、高輝度エレク トロルミネッセンス(EL)の実現を目指す。

3. 研究の方法

本研究では、提案するハイブリッド量子ドッ ト系において、キャリア移動および再結合過 程を制御する手法を実験的に探求する。具体 的には、以下の4項目に力点をおいて、研究 を推進した。

(1) 自己整合一次元連結 Si 系量子ドットの 形成

(2) 高密度自己整合集積した Si 系量子ドットのエレクトロルミネッセンス

(3) 3.AFM/KFM による一次元連結・高密度
Si 系量子ドットの帯電状態の経時変化計測
(4)一次元縦積み連結 Si 系量子ドットの室
温共鳴トンネル伝導

4. 研究成果

(1)自己整合一次元連結Si系量子ドットの形成 n-Si(100) 基板上に1000°C、2%O₂で膜厚 ~4.2nmのSiO₂を形成し後、希釈HF処理を行っ た後、SiH₄ガスのLPCVD(580°C)によりSi量子 ドットを自己組織的に形成した。その後、 GeH₄-LPCVD(410°C)によりSi量子ドット上に Geを選択成長した後、大気圧で熱酸化した。 引き続き、高温真空熱処理により、Si量子ド ットの核形成サイトとなるSi熱酸化膜表面の OH基およびGe表面酸化層の熱脱離を行った。 その後、再度SiH₄-LPCVD(580°C)を行った。い ずれのプロセスも、同一チャンバ内において 真空一貫で行った。

各工程における表面形状像をFig.1に示す。 第一段階目のSiH₄-LPCVD後(a)では、面密度 ~1.0×10¹¹cm⁻²、平均ドット高さ~6nmのSi量子 ドットの形成が認められる(a')。その後の GeH₄-LPCVD(b)さらに熱酸化後(c)では、面密 度が変化することなく、個々のドット高さが 各々~2および~3nm増大し、熱酸化後において はドット直径が初期のSi量子ドットに比べ ~2-3倍膨張していることから、熱酸化後では Si量子ドット上に選択成長したGeと共にドッ ト側面の酸化が進行していると考えられる (c')。また、酸化過程時にGe酸化物が熱脱離し ていることも高分解能XPSにより確認してい る。引き続き、高温真空アニールした後(d)で は、ドット高さは~10nmに減少するが、面密 度およびドット直径に変化は認められなかっ た。これは、Ge酸化物が完全に熱離脱した結 果で解釈でき(d')、その後再度SiH₄-LPCVDを 行った後の表面形状像においては(e)、ドット の面密度および直径を保ったままドット高さ が~2nm増大することから、ドット上へのSiの 選択成長(e')が示唆され、一次元に縦積連結し たSi量子ドット構造の実現を示している。



Fig. 1 AFM images ((a) - (e)) taken after each process step as indicated in Fig 1 and corresponding schematic illustrations ((a') - (e')). Typical AFM images of pre-grown Si-QDs ((a) and (a')), subsequent Ge deposition ((b) and (b')), after oxidation at 600 °C ((c) and (c')), after annealing at 1000 °C under vacuum condition ((d) and (d')) and subsequent Si-QDs formation ((e) and (e')).

(2)高密度自己整合集積したSi系量子ドットの エレクトロルミネッセンス

SiO2上に高密度形成したSi量子ドット(面密

度:~10¹³cm⁻²、ドット高さ:~2.0nm)上にGeH₄-LPCVDによりGeを選択成長した後 (a, a')お よび熱酸化後(b, b')の表面形状像および模式 図をFig. 2に示す。GeH₄-LPCVD後では、面密 度が変化することなく個々のドット高さが僅 かながら増大するが、熱酸化後においてはド ットの形状が完全に消失する。これは、ドッ ト表面の熱酸化に伴う体積膨張によって隣接 するドット間がシリコン酸化物で充填され量 子ドットが埋め込まれた結果と考えられる (b')。実際に、この表面熱酸化後の高温真空ア ニールによって、ドット表面に形成されるGe 酸化物を熱脱離させた場合にも、表面形状像 に顕著な変化は認められなかった。Ge酸化物 の熱脱離後に引き続づいて、SiH₄-LPCVDによ りSi量子ドットを自己整合的に縦積み形成し た。形成した一次元連結ドット構造を発光層 とした半透明Au電極のダイオード構造にお いて、Au電極とn-Si(100)基板の仕事関数差を



Fig. 2 AFM images taken after Ge deposition onto pre-grown Si-QDs (a) and after Oxidation at 600° C (b) and corresponding schematically illustrations ((a') and (b')).



Fig. 3 Electroluminescence (EL) spectra from an Au/self-aligned Si-QDs/n-Si(100) diode, which were taken at different forward biases at 297 K.

反映した明瞭な整流特性が認められ、順方向 バイアス印加時に近赤外領域で室温ELが観 測された(Fig. 3)。ELのしきい値電圧は~1.2V 程度で、~1130 nmと~1030nmピーク波長を持

つ発光成分が認められ、ゲート電圧の増加に 伴って、~1130 nm成分の増大が顕著なために 、短波長側に裾を引いたELスペクトルになる 。なお、逆方向バイアス印加ではELは認めら れなかった。EL積分強度を電流密度に対して まとめた結果(Fig. 4)、低密度に形成した縦積 連結ドット(面密度:~10¹¹cm⁻²)に比べ、発光強 度が2桁以上増大する結果が得られた。これは 、縦積連結ドットを高密度化することにより ドットを介さない電流成分が抑制され、ド ット内への電子・正孔注入が高効率に起こる ことでEL効率が向上したと示唆される。-一方 p-Si(100) 基板上に作成したダイオード構造 において、Au電極から電子を、基板から正孔 を注入することで、n-Si(100)基板上の試料と 同様な室温近赤外発光が認められ、ELのしき い値電圧は~2.0V程度であり、n-Si(100)基板上 の試料の値(~1.2V)よりも高いことが分かった 。この違いは、基板の仕事関数差を反映した 結果と言える。また、ELスペクトルの印加バ イアス依存性は、~1140 nmと~1080nmにピー ク波長を持つ2成分の相対比率の変化で説明 できる。各プロセス時に測定した表面形状像 およびXPS分析により、基板側のSiドットには Geが混入していることが分かっているため、 観測された2成分は、1層目と2層目のドットで の発光再結合に対応し、それぞれ、長波長成 分と短波長成分と考えられる。また、観測さ れた2成分のEL積分強度を印加電圧および投 入電力の関数としてまとめた結果(Fig. 5)、EL 強度の電圧依存性、電力依存性いずれにおい ても、概ねべき乗則に従っており、基板の伝





導タイプに関わらず、長波長成分のべき数が 短波長成分に比べてやや大きくなっているこ とが分かった。基板側のドットは、表面側の Si系ドットに比べて、正孔に対して深いポテ ンシャル井戸が形成されることを考慮すると



Fig. 5 Integrated EL intensities of 2 comportment peaks at \sim 1140nm (Peak 1) and \sim 1080nm (Peak2) from the diodes of n- and p-Si(100) as functions of applied gate voltage (a) and power (b), respectively.

、p-Si(100)基板では、基板側ドットに注入された正孔の表面側ドットへの輸送が抑制されるため、長波長側の信号強度が顕在化すると解釈できる。n-Si(100)基板では、基板からの電子注入およびAu電極からの正孔注入が低バイアス印加で促進するものの、正孔は基板へ抜けることなく基板側ドットの深いポテンシャル井戸に閉じ込められるため、基板からの注入電子が、高効率に再結合すると考えられる。

(3)AFM/KFM による一次元連結・高密度Si 系量子ドットの帯電状態の経時変化計測

導電性AFM探針を用いたAFM/KFM測定に おいて、n-Si(100)基板上に形成した高密度・ 一次元連結ドットにTipバイアス-1.5Vを印加 して、500nm×500nm²の領域内を表面走査した 後の表面電位像には、Tipからドットへの電子 注入に起因した負帯電(-50mV)が認められた。 その後、表面電位像の経時変化を測定した結 果(Fig. 6(a))、負帯電領域の表面電位は、時間 の経過につれて多段階に減少することが明ら かになった。この時、電位像断面プロファイ ルから算出した電位変化領域の半値幅は、一 旦緩やかに増大した後に減少する。これらの 結果は、電圧印加直後に表面側の2層目ドット へ注入された電子がクーロン反発を緩和する ため、先ず隣接ドット間へ移動して負帯電領 域が拡がり、これに伴い電位変化量が減少す ることで表面側のドット内の保持電子が一時 的に安定化すると考えられる。35分から認め られる電位変化量の経時変化は、縦積み連結 構造において表面側のドット内に安定保持さ れていた電子が基板側の1層目ドットへ移動 して再度安定化した後、最終的には基板への 電子放出が顕在化すると解釈できる。

(4)一次元縦積み連結Si 系量子ドットの室温 共鳴トンネル伝導

超高密度形成した一次元連結 Si 系量子ド ット構造に導電性 AFM 探針を接触させ、局 所電流-電圧特性を評価した結果(Fig. 7)、印加 電圧 1.8V 近傍に、特異な電流増加と顕著な 負性微分抵抗特性が観測され、ピーク-バレ イ電流比は~2 桁を越えることが明らかにな った。さらに、3.4V 近傍においても、不鮮明 ながら電流ピークが認めら、熱 SiO₂/Si ドッ ト/SiO₂ 二重障壁構造における理論シミュレ ーション結果と類似の振る舞いであること から、観測された特異な伝導特性は量子化エ ネルギー準位を介した共鳴トンネル伝導で 解釈できる。



Fig. 6 Room temperature decay characteristics of surface potential changes and the full width at half maximum of the charged taken after applied tip biases at -1.5V in the area of 500×500 nm² region.



Fig. 7 Measured I-V characteristic for a self-aligned Si-based quantum dot structure. The inset illustrates the I-V measurement system.

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計 29 件)

① K. Makihara, H. Deki, M Ikeda and <u>S.</u> <u>Miyazaki</u>, "Electroluminescence from One-dimensionally Self-Aligned Si-based Quantum Dots with High Areal Dot Density", Jpn. J. Appl. Phys., 2012. 04DG08(5pages), DOI:10.1143/JJAP.51.04 DG08, 査読有

- ② S. Miyazaki, "Formation and Characterization of Silicon-Quantum-Dots/ Metal-Silicide-Nanodots Hybrid Stack and its Application to Floating Gate Functional Devices", ECS Trans., Vol. 41, 2011, pp. 93-98. http://dx.doi.org/10.1149/ 1.3633288, 査読有
- ③ K. Makihara, K. Matsumoto, M. Yamane, T. Okada, N. Morisawa, M. Ikeda, <u>S. Higashi</u> and <u>S. Miyazaki</u>, "Formation of High Density Pt Nanodots on SiO₂ Induced by Millisecond Rapid Thermal Annealing using Thermal Plasma Jet for Floating Gate Memory", Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 50, No. 8, 2011, 08KE06 (4pages). DOI: 10.1143/JJAP.50.08KE06, 査読有
- ④ M. Muraguchi, Y. Sakurai, Y. Takada, Y. Shigeta, M. Ikeda, K. Makihara, <u>S. Miyazaki</u>, S. Nomura, K. Shiraishi, and T. Endoh, "Collective Tunneling Model in Charge Trap Type NVM Cell", Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 50, No. 4, 2010, 04DD04 (4pages). DOI: 10.1143/JJAP.50.04DD04, 査読有
- ⑤ M. Muraguchi, Y. Sakurai, Y. Takada, S. Nomura, K. Shiraishi, M. Ikeda, K. Makihara, <u>S. Miyazaki</u>, Y. Shigeta, T. Endoh, "Study on Collective Electron Motion in Si-Nano Dot Floating Gate MOS Capacitor", IEICE, Vol. 94-C, No. 5, pp. 730-736. http://search.ieice.org/bin/pdf.php?lang=E& year=2011&fname=e94-c_5_730&abst=, 査読有
- ⑥ N. Morisawa, M. Ikeda, K. Makihara and <u>S. Miyazaki</u>, "Optical Response of Si-Quantum-Dots/NiSi-Nanodots Stack Hybrid Floating Gate in MOS Structures", Key Engineering Materials, Vol. 470, 2011, pp. 135-139. DOI: 10.4028/www.scientific. net/KEM.470.135, 査読有
- ⑦ K. Makihara, M. Ikeda, A. Ohta, S. Takeuchi, Y. Shimura, S. Zaima and <u>S. Miyazaki</u>, "High Density Formation of Ge Quantum Dots on SiO₂", Solid State Electronics, Vol. 60, 2011, pp. 65-69. http://dx.doi.org/10.1016/j.sse.2011. 01.035, 査読有

〔学会発表〕(計75件)

 [招待講演] 牧原克典、<u>宮崎誠一</u>,「一次 元縦積連結シリコン系量子ドットの形成 と発光ダイオードへの応用」, ED/CPM/SDM 研究会, 2012 年 5 月 17-18 日,豊橋技術科学大学ベンチャー・ビジ ネス・ラボラトリー

- ② [奨励賞受賞記念講演] 牧原克典、山根 雅人、池田弥央、<u>東清一郎、宮崎誠一</u>, 「熱プラズマジェットを用いたミリ秒熱 処理による Pt および Pt シリサイドナノ ドットの形成とフローティングゲートメ モリ応用」,第 59 回春季応用物理学会(於 早稲田大学),18a-B3-1,2012 年 3 月 15-18 日
- ③ 高見弘貴、牧原克典、出木秀典、池田弥央、<u>宮崎誠一</u>,「一次元連結 Si 系量子ドットの EL 特性評価」,第 59 回春季応用物理学会,(於 早稲田大学),18p-A1-5,2012年3月15-18日
- ④ 牧原克典、恒川直輝、池田弥央、<u>宮崎誠</u> 一,「AFM/KFM による一次元連結・高密 度 Si 系量子ドットの帯電状態の経時変 化計測」,第 59 回春季応用物理学会,(於 早稲田大学),18p-A1-8,2012年3月15-18 日
- ⑤ 牧原克典、池田弥央、<u>宮崎誠一</u>,「一次元 縦積み連結 Si 系量子ドットの室温共鳴 トンネル伝導」,第 59 回春季応用物理学 会,(於 早稲田大学),18p-A1-7,2012年3 月 15-18 日
- ⑥ 池田弥央、牧原克典、<u>宮崎誠一</u>,「Si 量 子ドット/NiSi ナノドットハイブリッド フローティングゲートにおける光励起電 子のパルス電圧応答」,第59回春季応用 物理学会,(於 早稲田大学),18a-GP6-11, 2012年3月15-18日
- ⑦ K. Makihara, M. Ikeda, A. Ohta and <u>S. Miyazaki</u>, "Formation of PtAl-Alloy Nanodots on Ultrathin SiO₂ Induced by Remote Hydrogen Plasma", The 5th International Conference on Plasma-Nano Technology & Science (IC-PLANTS 2012), (Inuyama, Mar. 3-9, 2012) P-65.
- (8) M. Ikeda, K. Makihara, A. Ohta and <u>S. Miyazaki</u>, "Formation of High Density Ge Quantum Dots and Their Electrical Properties", The 5th International Conference on Plasma-Nano Technology & Science (IC-PLANTS 2012), (Inuyama, Mar. 3-9, 2012) P-63.
- (9) K. Makihara, H. Deki, M. Ikeda and <u>S. Miyazaki</u>, "Formation of One-Dimensionally Self-Aligned Si-based Quantum Dots on Untrathin SiO₂ and Its Application to Light Emitting Diodes", 4th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials (ISPlasma2012), (Kasugai, Mar. 3-9, 2012) P2105C.
- 10 K. Makihara, M. Ikeda, A. Ohta, R. Ashihara,

<u>S. Higashi</u> and <u>S. Miyazaki</u>, "Formation of PtAl Nanodots Induced by Remote Hydrogen Plasma", 15th International Conference on Thin Films (ICTF-15), (Kyoto, Nov. 8-11, 2011) P-S2-27.

- S. Miyazaki, K. Makihara, A. Ohta and M. Ikeda, "Electrical Charging Characteristics of Hybrid Nanodots Floating Gates in MOS Devices", 15th International Conference on Thin Films (ICTF-15), (Kyoto, Nov. 8-11, 2011) P-S2-26.
- Invited] S. Miyazaki, "Formation and Characterization of Silicon-Quantum-Dots/ Metal-Silicide- Nanodots Hybrid Stack and its Application to Floating Gate Functional Devices", 220th Electrochemical Society (ECS) Meeting, Boston, MA, Oct., 9-14, 2011, #2157.
- K. Makihara, H. Deki, M Ikeda and <u>S. Miyazaki</u>, "Electroluminescence from One-dimensionally Self-Aligned Si-based Quantum Dots with High Areal Dot Density", 2011 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM), (Nagoya, Sept. 28-30, 2011) I-8-1.
- ④ 牧原克典、池田弥央、山根雅人、<u>東清一郎、宮崎誠一</u>,「プラズマジェット急速熱処理による高密度Ptナノドット形成とフローティングゲートメモリ応用」,第72回秋季応用物理学会,(於山形大学),2p-ZQ-3,9月2011年8月29-9月2日
- 高見弘貴、牧原克典、出木秀典、池田弥央、<u>宮崎誠一</u>,「一次元連結・高密度 Si 系量子ドットにおける EL 発光」,第 72 回秋季応用物理学会,(於山形大学), 2a-J-3,2011年8月29-9月2日
- (f) [Invited] <u>S. Miyazaki</u>, Characterization of La- and Mg-Diffused HfO₂/SiO₂ Stack Structures of for Next Generation Gate Dielectrics, 7th Pacific Rim International Conference on Advanced Materials and Processing (PRICM7), Cairns, Australia, Aug. 2-6, 2011.
- Invited] S. Miyazaki, "Formation of Hybrid Nanodots Floating Gate for Functional Memories", International Conference on Processing & Manufactturing of Advanced Materials (Themec'2011), Quebec, Canada, Aug. 1-5, 2011, NANO-1-7.
- [招待講演] <u>宮崎誠一</u>,化学気相成長法, 日本学術振興会 薄膜第131委員会 第28
 回 薄膜スクール,松風園,蒲郡,2011 年 7月20日~22日.
- 19 K. Makihara, M. Ikeda, A. Ohta and <u>S. Miyazaki</u>, "Electrical Characterization of NiSi-NDs/Si-QDs Hybrid Stacked Floating Gate in MOS Capacitors", 2011 Asia-Pacific

Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices (AWAD 2011), Daejeon, Korea, June 29 - July 12, 2011, 1A.11.

(パネラー) <u>宮崎誠一</u>, ランプセッション「エレクトロニクスを支える電子材料~2020年への展望~」, 30th Electronic Materials Symposium, ラフォーレ琵琶湖, 2011年6月29日~7月1日.

[その他]

ホームページ等

http://www.nuee.nagoya-u.ac.jp/labs/miyazakilab

6. 研究組織

(1)研究代表者
宮崎 誠一(MIYAZAKI SEIICHI)
名古屋大学・工学研究科・教授
研究者番号:70190759

(2)研究分担者

村上 秀樹 (MURAKAMI HIDEKI) 広島大学・先端物質科学研究科・助教 研究者番号:70314739 東 清一郎 (SEIICHIRO HIGASHI) 広島大学・先端物質科学研究科・教授 研究者番号:30363047 (H21→H22:研究協力者)

(3)連携研究者なし